



Nokia 选择 Broadcom 作为其未来 EDGE 手机的套片供应商

北京，2007年8月9日——全球有线和无线通信半导体领导者 Broadcom（博通）公司(Nasdaq: BRCM)宣布其先进的单芯片手机基带处理器以及配套的电源管理器件（PMU）被 Nokia 公司选中用于其未来部分 EDGE 手机的设计。

“Nokia 一直在密切关注 Broadcom 公司单芯片 EDGE 处理器的发展，也因此被 Broadcom 团队所取得的进步而打动。” Nokia 手机业务拓展部高级副总裁 Peter Ropke 先生表示：“Broadcom 公司的 EDGE 解决方案提供了在低功耗，小规格以及低系统成本下的先进功能，为 Nokia 未来的 EDGE 手机产品提供了十分理想的设计基础。”

Broadcom 公司高级副总裁兼移动平台部总经理 Yossi Cohen 先生表示：“被选作 Nokia EDGE 合作伙伴，Broadcom 感到十分荣幸。公司同时也为可以有机会与 Nokia 公司一起进行紧密的合作而感到欣喜。Nokia 公司完备的技术评估流程很好的证明了其为保证未来手机技术优势的而采取的不妥协政策。”

Broadcom 公司在 2007 年 2 月 3GSM 大会上首先宣布的 BCM21331（“Venus”）单芯片 EDGE 多媒体处理器，利用了 65 纳米 CMOS 处理技术设计而成。BCM21331 集成了 EDGE RF 收发器，全面的模拟和数字基带功能，并且支持高性能的多媒体和连通性。与高集成和高功效的 BCM59035PMU 的配合，可以使新的解决方案适应于小型电路板空间和需要高集成、低功耗、低原材料成本的超薄型设计中。

iSuppli 无线通信的资深分析员 Francis Sideco 表示：“Broadcom 公司在技术发展和市场表现方面都取得了长足的进步。Nokia 和 Broadcom 此次的重要的合作是瞄准了 EDGE 这部分非常重要的市场。”

根据 iSuppli 的市场调查，在移动手机市场中 EDGE 领域的发展，预计可以从 2007 年的 2.45 亿件到 2009 年增长至超过 4.08 亿件。

关于 **Broadcom**

Broadcom（博通）公司为全球有线及无线通讯半导体业的领导者。其产品协助语音、影像、数据和多媒体的传输能遍及家庭、企业及移动环境。针对信息及网络设备、数字娱乐及宽带接取产品，以及行动装置的制造业者，**Broadcom** 提供业界最完整的先进系统单芯片和软件解决方案。这些解决方案都支撑了我们的核心信念：**Connecting Everything®**（连接一切）。

Broadcom 是全球最大的无晶圆生产半导体公司之一，2006 年营收超过 36.7 亿美元。**Broadcom** 拥有 2000 多个美国专利，800 个国外专利，另外还有 6000 个待批的专利申请，在有线和无线领域的语音、影像、数据传输方面拥有非常广泛的知识产权。

总部位于加州尔湾市，并于北美、亚洲和欧洲设有办公室及研究机构。联络 **Broadcom** 请电 1-949-926-5000，或上网 www.broadcom.com。

Broadcom 行业媒体联系人

Jeremy Hyatt

企业传播资深经理

949-926-5971

jhyatt@broadcom.com

Broadcom 技术联系人

Mike Civiello

资深市场总监

480-753-2288

civiello@broadcom.com

Broadcom 投资关系联系人

T. Peter Andrew

企业传播副总裁

949-926-5663

andrewtp@broadcom.com

e21 摩奇公司媒体联系人

袁冰 Maggie Yuan

00-86-10-65661616 ext. 130

maggie.yuan@e21mm.com

韩秋旭 Helen Han

00-86-10-65661616 ext. 135

helen.han@e21mm.com